光罩製作

- **對應計畫:**
  1. R451AA1460(智慧模組高值應用場域實證計畫_感測)。

- **目的/用途:**
  1. 因應智慧模組高值應用場域IMU感測晶片之光罩製作。

- **預計達成效果或產生之效益:**
  1. 透過光罩製作讓感測元件實際下線，以便對後續的設計進行評估。

- **規格:**
  1. Mask Type: 9”x9”x0.12” Soda lime mask, CD & Tolerance:≥-2±0.2um
  2. Mask Type: 6”x6”x0.25” Quartz mask, CD & Tolerance:≥-1±0.1um

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

©ITRI. 工業技術研究院著作